

제출문

제 출 문

한국건설기술연구원 미래스마트건설연구본부 귀하

‘형태의 한계를 극복한 3D 프린팅 몰드와 두께 10mm 혁신적 UHPC를 이용한 비정형 프리폼 건축물 외장패널 설계·생산·시공 통합플랫폼 개발’(연구개발 기간 : 2021. 04. 01 - 2023. 12. 31) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2024 . 5. 30 .

주관연구기관명 : (주)위시스테크놀로지 김성진



공동연구기관명 : 세종대학교 유상호



공동연구기관명 : (주)위드웍스에이앤이건축사사무소 권혁찬,김성진



공동연구기관명 : 아주산업(주) 박상일



공동연구기관명 : 선원건설(주) 맹학열



주관연구기관책임자: 김성진
공동연구기관책임자: 이기학
공동연구기관책임자: 박정준
공동연구기관책임자: 박용규
공동연구기관책임자: 오성운

국토교통부소관 연구개발사업 운영규정 제37조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.